

PRODUCT CHANGE NOTICE

产品变更通知

Subject 主題:	PCN#	 编号:	20230207-001	Date 日期:	2023-02-07					
PROVIDENCE COME PROVIDED BY COME TO SET THE PROVIDED BY COME OF SET OF	Subject 主题:									
PROVIDENCE COME PROVIDED BY COME TO SET THE PROVIDED BY COME OF SET OF	36. T									
Phone 电话: O21-50838601 Dept.部门: 质量部 Quality Change Details 変更说明 Class 1 Class 2 Class 3 Class 4 Change Type 変更类型: Wafer Fabrication 晶圆制造 F Assembly 對装 Test 测试 Product Revision 产品改版 Dept.都们: Product Revision 产品改版 Dept.都们: Product Revision 产品改版 Dept.和fine										
Change Classification 变更等级: Class 1	-				8601 Dent 部门: 质量部 Quality					
Change Type 变更类型: Wafer Fabrication 晶圆制造	Origin									
Wafer Fabrication 晶圆制造	Chan	ge Classification 变			Class 3 Class 4					
Datasheet 产品规格书	Chan	ge Type 变更类型:								
Datasheet 产品规格书	□w	afer Fabrication 晶圆	制造 Assembly 封装	□ Test 测试	□ Product Revision 产品改版					
Description of Changes 变更描述: DC 规则变更 Date Code rules changes DC 规则统一更新为 YYWWS(YY-年+WW-周+S-内部追溯码) DC rules are uniformly updated to YYWWS. (YY-Year/WW-Week/S-internal traceability code) 1. SOIC 系列 SOCI series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 芯片及射装批次信息 内部追溯D/C: SSXXYYWWX WSOP8 系列 MSOP series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 内部追溯D/C: SSXXYYWX AFS MSOP8 系列 MSOP series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 内部追溯D/C: YYWWS AFS DFN/QFN (3x3)系列 DFN/QFN (3x3) series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 内部追溯D/C: YYWWS AFS AFS AFS AFS AFS AFS AFS AFS AFS A			7 = 3.23		, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
DC 规则变更 Date Code rules changes DC 规则统一更新为 YYWWS(YY-年+WW-周+S-内部追溯码) DC rules are uniformly updated to YYWWS. (YY-Year/WW-Week/S-internal traceability code) 1. SOIC 系列 SOCI series Package 变更前 Before 变更后 After **** *****************************	□ Da	atasheet 产品规格	书 ☐ End of Line 停产 ☐ O	ther其它						
DC 规则变更 Date Code rules changes DC 规则统一更新为 YYWWS(YY-年+WW-周+S-内部追溯码) DC rules are uniformly updated to YYWWS. (YY-Year/WW-Week/S-internal traceability code) 1. SOIC 系列 SOCI series Package 变更前 Before 变更后 After **** *****************************	Description of Changes 变更描述:									
DC 规则统一更新为 YYWWS(YY-年+WW-周+S-内部追溯码) DC rules are uniformly updated to YYWWS. (YY-Year/WW-Week/S-internal traceability code) 1. SOIC 系列 SOCI series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 芯片及封装批次信息 内部追溯D/C: SSXXYYWWX 2. MSOP8 系列 MSOP series Package 变更前 Before 零更后 After 料号 内部追溯D/C: SSXXYYWXX AFS Package 不要更前 Before 不要更后 After 科号 内部追溯D/C: SSXXYYWX AFS Package 不要更前 Before 不要更后 After 科号 内部追溯D/C: YYWWS AFS Package 不要更前 Before 不要更后 After 科号 内部追溯D/C: YYWWS AFS Package 不要更前 Before 不要更后 After AFS Package 不要更前 Before 不要更后 After AFS AFS AFS AFS AFS AFS AFS AFS AFS AF										
DC rules are uniformly updated to YYWWS. (YY-Year/WW-Week/S-internal traceability code) 1. SOIC 系列 SOCI series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 芯片及封装批次信息 内部追溯D/C: SSXXYYWWX 人 A WSOP8 系列 MSOP series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 芯片及对装批次信息 内部追溯D/C: YYWWS A SOIC Series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 内部追溯D/C: SSXXYYWX A DFN/QFN (3x3)系列 DFN/QFN (3x3) series Package 变更前 Before 变更后 After A Package 变更前 Before 少更后 After A A A A A A A A A A A A A	DC 规	则变更 Date Code	e rules changes							
1. SOIC 系列 SOCI series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 芯片及封装批次信息 内部追溯D/C: SSXXYYWWX ASOP8 系列 MSOP series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 内部追溯D/C: SSXXYYWX ASOP8 系列 MSOP series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 内部追溯D/C: SSXXYYWX ASOP8 系列 MSOP series Package 季更前 Before 季更后 After 科号 内部追溯D/C: SSXXYWX ASOP8 系列 MSOP series Package 季更前 Before 季更后 After 科号 内部追溯D/C: SSXXYWX ASOP8 系列 MSOP series Package 季更前 Before 季更后 After	DC 规则统一更新为 YYWWS(YY-年+WW-周+S-内部追溯码)									
Package 变更前 Before 变更后 After AFF										
SOIC系列 SOIC series	1.	. SOIC 系列 SOCI series								
SOIC 系列 SOIC series		Package	变更前 Before	3	变更后 After					
SOIC 系列 SOIC series										
2. MSOP8 系列 MSOP series Package 变更前 Before 变更后 After MSOP8系列 MSOP series Phackage 本理前 Before 本号 内部追溯D/C: YYWWS 内部追溯D/C: YYWWS 3. DFN/QFN (3x3)系列 DFN/QFN (3x3) series Package 变更前 Before 变更后 After Package 变更前 Before ** Package **			料号	料号						
2. MSOP8 系列 MSOP series Package 变更前 Before 变更后 After MSOP8系列 MSOP series A 号 内部追溯D/C: SSXXYWX A P			芯片及封装批次信息	芯片及	封装批次信息					
2. MSOP8 系列 MSOP series Package 变更前 Before 变更后 After MSOP8系列 内部追溯D/C: SSXXYWX 内部追溯D/C: YYWWS 3. DFN/QFN (3x3)系列 DFN/QFN (3x3) series Package 变更前 Before 变更后 After Package 亦更前 Before 亦是后 After 科号 小科号 小科号 本片及封装批次信息		bord series		内部追						
Package 变更前 Before 变更后 After MSOP8系列										
MSOP8系列 MSOP series	2.	2. MSOP8 系列 MSOP series								
MSOP8系列 MSOP series 内部追溯D/C: SSXXYWX 内部追溯D/C: YYWWS 3. DFN/QFN (3x3)系列 DFN/QFN (3x3) series Package 变更前 Before 变更后 After 科号		Package	变更前 Before	多	医更后 After					
MSOP8系列 MSOP series 内部追溯D/C: SSXXYWX 内部追溯D/C: YYWWS 3. DFN/QFN (3x3)系列 DFN/QFN (3x3) series Package 变更前 Before 变更后 After 科号				w1 P.						
3. DFN/QFN (3x3)系列 DFN/QFN (3x3) series Package 变更前 Before 变更后 After 科号 DFN/QFN (3x3) 本持及封装批次信息		MSOP8系列			自瀨D/C: YYWWS					
Package 变更前 Before 变更后 After DFN/QFN (3x3)		MSOP series	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	P3 HP2	Embro. TTWWV3					
Package 变更前 Before 变更后 After DFN/QFN (3x3)										
DFN/QFN (3x3) 料号 お片及封装批次信息 本片及封装批次信息	3.	DFN/QFN (3x3)系列								
DFN/QFN (3x3) 芯片及封装批次信息 内部追溯D/C: SSYWX		Package	变更前 Before	3	 E更后 After					
DFN/QFN (3x3) 芯片及封装批次信息 内部追溯D/C: SSYWX				•						
内部追溯D/C·SSYWX		DEN/OEN (2×2)	料号							
F 3 HP ALL DIJLOTO		DEN/QEN (5X5)	内部追溯D/C: SSYWX							
				, 1 m						



QFN 4x4 系列 QFN 4x4 series

Package	变更前 Before	变更后 After
QFN 4x4	料号 芯片及封装批次信息 内部追溯D/C: SSXXYWX	料号 芯片及封装批次信息 内部追溯D/C: YYWWS

DUB8 系列 DUB8 series 5.

封装形式	变更前 Before	变更后 After
DUB8	料号 芯片及封装批次信息 内部追溯D/C: SSXXYYWWX	料号 芯片及封装批次信息 内部追溯D/C: YYWWS

Reason for Changes 变更原因:

简化 DC 规则,便于客户有效区分生产年周

Simplify DC rules to facilitate customers to effectively distinguish production years and weeks

Impact of the change (positive or negative) on fit, form, function & reliability

变更(正面或负面)对外观、尺寸、功能和可靠性的影响:

对产品外观、尺寸、功能可靠性无影响

No effect on product appearance, size, function, and reliability

Affected Part Number 受影响产品型号:

川土微电子所有 SOIC 系列/ MSOP8 系列/ DFN/QFN (3x3)系列/ QFN 4x4 系列/ DUB8 系列产品 All SOIC series / MSOP8 series / DFN/QFN (3x3) series / QFN 4x4 series / DUB8 series products

Samples Status 样品状态:

量产及开发的所有产品

All products in mass production and development

Implementation Date 实施日期:

- 2023 年 2 月份新生产的产品均启用新的印字(Date code 2308 开始生产的物料启用新的印字规范) 1) Start in Feb. 2023, new DC rules will be used for all newly produced products.
- 库存产品自然断点(正常交付至交付完毕为止)

Natural breakpoints for inventory products (normal delivery until delivery is completed)

Appendix 附件:

无 NA

Remark: After Chipanalog notice of change is issued, for class 1 change, please review within 30 calendar days. For class 2 change, please review within 15 calendar days. If there is any problem, please feedback timely. If there is no feedback, you will agree to the change by default. 备注:川土变更通知发出后,一级变更请您在 30 天内进行评审,二级变更请您在 15 天内进行评审。若有问题,请您及时反馈。若未反馈,默认您同意变更。

For additional information regarding this change, contact your local sales representative or contact the PCN administrator at chenliang@chipanalog.com. 有关此更改的其他信息,请联系销售代表或 PCN 管理员: chenliang@chipanalog.com.